JIS

プリント配線板実装－第３部：部門規格－
挿入実装はんだ付け要求事項

JIS C 61191-3：2020

（IEC 61191-3：2017）

（JEITA/JSA）

令和２年３月23日　改正

日本産業標準調査会 審議

（日本規格協会 発行）

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業標準調査会標準第二部会 構成表

	氏名	所属
（部会長）	大 崎 博 之	東京大学
（委員）	青 柳 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	伊 藤 智	一般社団法人情報処理学会情報規格調査会（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）
	岩 渕 幸 吾	一般社団法人電子情報技術産業協会
	内 田 富 雄	一般財団法人日本規格協会
	江 崎 正	IEC/SMB 日本代表委員（ソニー株式会社）
	住 谷 淳 吉	一般財団法人電気安全環境研究所
	高 村 里 子	全国地域婦人団体連絡協議会
	田 中 一 彦	一般社団法人日本電機工業会
	橋 爪 弘	一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
	平 田 真 幸	IEC/CAB 日本代表委員（富士ゼロックス株式会社）
	藤 原 昇	一般社団法人電気学会
	水 本 哲 弥	東京工業大学
	山 根 香 織	主婦連合会

主 務 大 臣：経済産業大臣　　制定：平成 18.3.25　　改正：令和 2.3.23
官 報 掲 載 日：令和 2.3.23
原 案 作 成 者：一般社団法人電子情報技術産業協会
（〒100-0004　東京都千代田区大手町 1-1-3　大手センタービル　TEL 03-5218-1050）
一般財団法人日本規格協会
（〒108-0073　東京都港区三田 3-13-12　三田 MT ビル　TEL 03-4231-8530）
審 議 部 会：日本産業標準調査会　標準第二部会（部会長　大崎　博之）

この規格についての意見又は質問は，上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際電気標準課（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1）にご連絡ください。

なお，日本産業規格は，産業標準化法の規定によって，少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され，速やかに，確認，改正又は廃止されます。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

目　次

ページ
序文 1
1　適用範囲 1
2　引用規格 1
3　用語及び定義 1
4　一般要求事項 2
5　部品の挿入実装 2
5.1　一般事項 2
5.2　取付精度 2
5.3　挿入実装部品の要求事項 2
6　受入要求事項 5
6.1　一般事項 5
6.2　管理及び是正処置 5
6.3　挿入実装部品リードのはんだ付け 5
7　不適合はんだ接合の手直し 7
附属書 A（規定）挿入実装部品の取付け要求事項 8
参考文献 13
解　説 15

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，**JIS C 61191-3**:2006 は改正され，この規格に置き換えられた。

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。

JIS C 61191 の規格群には，次に示す部編成がある。

JIS C 61191-1　第 1 部：通則－表面実装及び関連する実装技術を用いた電気機器・電子機器用はんだ付け実装要求事項

JIS C 61191-2　第 2 部：部門規格－表面実装はんだ付け要求事項

JIS C 61191-3　第 3 部：部門規格－挿入実装はんだ付け要求事項

JIS C 61191-4　第 4 部：部門規格－端子実装はんだ付け要求事項

JIS C 61191-6　第 6 部：BGA 及び LGA のはんだ接合部のボイド評価基準及び測定方法

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格　　JIS
C 61191-3：2020
(IEC 61191-3：2017)

プリント配線板実装－第3部：部門規格－挿入実装はんだ付け要求事項

Printed board assemblies—Part 3: Sectional specification—
Requirements for through-hole mount soldered assemblies

序文

この規格は，2017年に第2版として発行された**IEC 61191-3**を基に，技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格である。

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。

1　適用範囲

この規格は，挿入実装のはんだ付けに対する要求事項について規定する。この要求事項は，全ての挿入実装技術（以下，THTという。）及びその他の関連技術（例えば，表面実装技術，チップ実装及び端子実装）を含む組立品のTHTに適用する。

注記　この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。

IEC 61191-3:2017，Printed board assemblies－Part 3: Sectional specification－Requirements for through-hole mount soldered assemblies（IDT）

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，**ISO/IEC Guide 21-1**に基づき，“一致している”ことを示す。

2　引用規格

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS C 61191-1:2015　プリント配線板実装－第1部：通則－表面実装及び関連する実装技術を用いた電気機器・電子機器用はんだ付け実装要求事項

注記　対応国際規格：**IEC 61191-1**:2013，Printed board assemblies－Part 1: Generic specification－Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies（MOD）

IEC 60194，Printed board design, manufacture and assembly－Terms and definitions

3　用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は，**IEC 60194**によるほか，次による。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。